

Efficient Power Conversion (EPC)、高電力密度の通信、ネットコム、コンピューティングのソリューションに最適な定格 40 V の eGaN FET を発売

EPCは、耐圧40 V、オン抵抗1.3 m Ω のeGaN® FETである<u>EPC2067</u>を発売し、高性能でスペースに制約のあるアプリケーション向けに、MOSFETよりも小型、高効率で、信頼性の高いデバイスを提供します。

エンハンスメント・モードの窒化ガリウム・オン・シリコン(eGaN)のパワーFET と IC の世界的リーダーである EPC(Efficient Power Conversion Corporation、本社:カリフォルニア州エルセグンド)は 10 月 27 日、eGaN FET の「EPC2067」(標準 1.3 m Ω 、40 V)を発売し、低電圧の既製の窒化ガリウム・トランジスタの選択肢を拡大したと発表しました。

EPC2067 は、48 V~54 V 入力のサーバーなど、高電力密度化に対する厳しい要件があるアプリケーションに最適です。より小さいゲート電荷と逆回復損失ゼロによって、最先端の電力密度が得られ、面積がわずか 9.3 mm²、高効率で 1 MHz 以上の高周波動作が可能です。

「EPC2067 は、LLC DC-DC コンバータの 2 次側向けに、 $40 \, \text{V} \sim 60 \, \text{V}$ 入力、 $12 \, \text{V}$ 出力の理想的なスイッチになります。この $40 \, \text{V}$ のデバイスは、前世代の $40 \, \text{V}$ の GaN FET と比べて性能とコストが改善されているので、経済的に、 効率と電力密度を向上できます」と共同創立者で CEO(最高経営責任者)の Alex Lidow(アレックス・リドウ)は述べています。

開発基板

開発基板の <u>EPC90138</u> は、最大デバイス電圧 40 V、最大出力電流 40 A で、ゲート駆動回路 を備えたハーフブリッジで、eGaN FET の <u>EPC2067</u> を搭載しています。この $2 \text{ インチ} \times 2$ インチ($50.8 \text{ mm} \times 50.8 \text{ mm}$)の基板は、最適なスイッチング特性を実現するために設計されており、EPC2067 を簡単に評価するためのすべての重要な部品が搭載されています。

EPC について

eGaN は、Efficient Power Conversion Corporation, Inc.の登録商標です

報道関係の問い合わせ先

Efficient Power Conversion: Winnie Wong (winnie.wong@epc-co.com)